

Veröffentlichung: 01.06.2021 14:03

EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S plant eine Investition von bis zu 1,7 Mrd. € in zusätzliche Kapazitäten für IC-Substrate in Südostasien

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

kein Stichwort

01.06.2021

Leoben -

- * Zustimmung des Aufsichtsrats noch ausständig
- * Investitionsvorhaben basiert auf der geplanten Zusammenarbeit mit großen Halbleiterherstellern
- * Wesentlicher Teil der Projektfinanzierung basiert auf Vereinbarungen mit Kunden - Kapitalmarkttransaktion nicht erforderlich
- * Im Fall der Investition ergibt sich folgende Prognose für 2025/26: Umsatz von rund 3 Mrd. EUR und EBITDA-Marge von 27 - 32 %

Die AT&S AG, einer der führenden Hersteller von High-End-Leiterplatten und IC-Substraten, plant vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats einen neuen Produktionsstandort für IC-Substrate in Südostasien zu errichten. Insgesamt sollen bis zu 1,7 Mrd. EUR in den Jahren 2021 bis 2026 in die Errichtung eines neuen Produktionskomplexes für High-End-Substrate investiert werden. Dies wäre die bisher größte Investition in der Unternehmensgeschichte von AT&S.

Das Vorhaben basiert auf und steht unter dem Vorbehalt der geplanten Zusammenarbeit mit zwei führenden Herstellern für High-Performance-Computing-Halbleitern, mit denen langfristige Verträge abgeschlossen werden sollen. Mit der Unterzeichnung dieser Verträge wird zeitnah gerechnet.

Rund die Hälfte des Investitionsvolumens soll durch Finanzierungsbeiträge der Kunden bereitgestellt werden, deren bilanzielle Darstellung noch zu klären ist. Jedenfalls ist eine Kapitalerhöhung durch Begebung neuer Aktien für die Finanzierung des Projekts nicht erforderlich.

Am Standort in Südostasien sollen ABF-Substrate für High-Performance-Prozessoren gefertigt werden. Diese finden Anwendung im Bereich Hochleistungsrechner, Datenzentren, Gaming, 5G, Automotive und KI. Der Produktionsstandort soll eine Gesamtgröße von rund 200.000 m² haben. Der Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2021 und der Start der Serienfertigung ist Ende 2024 geplant. Die derzeit geplanten Kapazitäten können bei vollständiger Auslastung ein zusätzliches Umsatzpotenzial von bis zu 1 Milliarde EUR pro Jahr generieren. Der Vorstand hebt die Bedeutung dieses Projekts hervor. Es trägt ganz wesentlich zur zukünftigen Diversifizierung des Kundenportfolios, der Verbreiterung des regionalen Footprints und der Positionierung im stark wachsenden Markt der ABF-Substrate bei.

In Fall dieser Investition als auch der Entwicklung in den anderen Geschäftsfeldern im Rahmen der Strategie "More than AT&S" geht der Vorstand von einer Geschäftsentwicklung mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2025/26 aus (2023/24: über 2 Mrd. EUR). Dies entspräche einem durchschnittlichen, jährlichen Wachstum (CAGR) bis 2025/26 von rund 20 %. Durch den verstärkten Fokus auf High-End-Applikationen in allen Bereichen kann eine Bandbreite bei der EBITDA-Marge von 27 bis 32 % (2023/24: 25 bis 30 %) erreicht

werden. Während der Projektlaufzeit bis zur Nutzung der Kapazitäten - abhängig von der bilanziellen Darstellung - könnte die Nettoverschuldungsquote (Nettoverschuldung/EBITDA) vorübergehend den mittelfristigen Zielwert von <3 überschreiten sowie die Eigenkapitalquote unter dem internen Zielwert von >30 % zu liegen kommen. Der mittelfristige Ziel-ROCE des Konzerns würde weiterhin bei >12 % liegen, dieser Zielwert soll mit Anlauf der Fertigung erreicht werden.

Rückfragehinweis:

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Gerda Königstorfer, Director Investor Relations

Mobile: +43 676 89555925

Email: g.koenigstorfer@ats.net

Ende der Mitteilung

euro adhoc

Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

A-8700 Leoben

Telefon: 03842 200-0

FAX:

Email: ir@ats.net

WWW: www.ats.net

ISIN: AT0000969985

Indizes: ATX, ATX GP, WBI, VÖNIX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch



Aussendung übermittelt durch euro adhoc
The European Investor Relations Service